

RJ45C5 R1V 3.2N4G/Y TY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ассортимент продукции включает следующие модели:

- 90°, лежащая (горизонтальная) и 180°, стоящая (вертикальная)
- Защелка верх / защелка вниз;
- Технология пайки THT или THR
- Широкий ассортимент различных видов конструкции, также со встроенными светодиодами и печатными площадками для экранирования
- Категория эксплуатационных характеристик от кат. 3 до кат. 6
- Упаковка – лоток (TY) или рулон (лента на катушке, RL)
- Совместимость с модульным разъемом RJ45 в соответствии со стандартами ANSI/TIA-1096-A и IEC 60603
- Диэлектрическая прочность ≥ 1500 В пер. тока, среднеквадратичное значение (2250 В пер. тока, амплитудное значение) в соответствии со стандартом IEEE 802.3
- Диэлектрическая прочность ≥ 1500 В перем. тока (амплитудное значение) или ≥ 1500 В пост. тока в соответствии со стандартом с IEC 60603

Особенности и преимущества:

- Расширенный диапазон температур: от -40 до $+85$ °C для достижения максимальных значений рабочих характеристик

- Слой золота повышенной прочности (30 мкм) для улучшения защиты от коррозии
- Расстояние по меньшей мере 0,3 мм обеспечивает отличный результат пайки

Основные данные для заказа

Исполнение	Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 5 . Соединение THT/THR под пайку, 180°, Выводы для экранирования: нет, 30...80 μ m Ni / ≥ 30 μ m Au , Светодиод: Да, зеленый, желтый, Количество полюсов: 8, Tray
Номер для заказа	2516380000
Тип	RJ45C5 R1V 3.2N4G/Y TY
GTIN (EAN)	4050118529944
Кол.	120 Шт.
Упаковка	Tray

Дата создания 11 апреля 2021 г. 12:19:16 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

RJ45C5 R1V 3.2N4G/Y TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	20 мм	Высота (в дюймах)	0,787 inch
Высота, мин.	16,5 мм	Глубина	16,7 мм
Глубина (дюймов)	0,657 inch	Масса нетто	3,417 g
Ширина	16 мм	Ширина (в дюймах)	0,63 inch

Упаковка

Упаковка	Tray	Длина VPE	0 м
VPE с	0 м	Высота VPE	0 м

Системные характеристики

Вид защиты	IP20	
Вид соединения	Гнездо	
Выводы для экранирования	нет	
Диаметр монтажного отверстия (D)	0,9 мм	
Длина контактного штифта (l)	3,2 мм	
Допуск на диаметр монтажного отверстия (D)	±0,1 мм	
Допуск на длину выводов под пайку	Нижний допуск с префиксом (показывает минимум)	-0,5
	Верхний допуск с префиксом (показывает максимум)	+0,5
	Допуск, единица	mm
Допуск на длину выводов под пайку	+0,5 / -0,5 mm	
Категория	Cat. 5	
Категория эксплуатационных характеристик	Cat. 5	
Количество контактных штырьков на полюс	1	
Количество полюсов	8	
Материал экрана	Латунь	
Монтаж	8-жильный	
Монтаж на печатной плате	Соединение THT/THR под пайку	
Поверхность экрана	никелированный	
Светодиод	Да	
Серия изделия	Данные OMNIMATE – модульный штекер RJ45	
Техпроцесс пайки	Пайка оплавлением сквозных отверстий (Reflow), Пайка вручную, Пайка волной припоя	
Угол вывода	180°	
Цвет левого светодиода	зеленый	
Цвет правого светодиода	желтый	
Шаг в дюймах (P)	0,05 inch	
Шаг в мм (P)	1,27 мм	
Экранирование	Да	

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7-51
---------------------------	----------------

Электрические свойства

Номинальное напряжение	125 V	Номинальный ток	1,5 A
Электрическая прочность, контакт / контакт	1500 В пост. тока		

Дата создания 11 апреля 2021 г. 12:19:16 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

RJ45C5 R1V 3.2N4G/Y TY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Данные о материалах**

Изоляционный материал	PA 9T	Цветовой код	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Группа изоляционного материала	II
Сравнительный показатель пробоя (СТИ)	>= 500	Moisture Level (MSL)	1
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Основной материал контактов	Фосфористая бронза
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Структура слоев штепсельного контакта	30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au
Температура хранения, мин.	-40 °C	Температура хранения, макс.	85 °C
Рабочая температура, мин.	-40 °C	Рабочая температура, макс.	85 °C

Классификации

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E471884

ЗагрузкиТехнические данные [STEP](#)

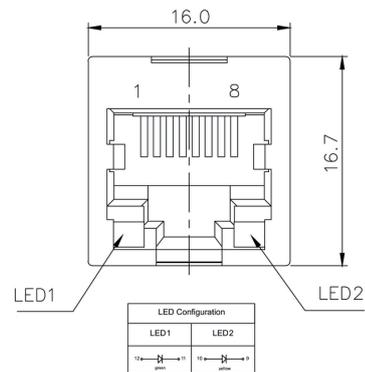
RJ45C5 R1V 3.2N4G/Y TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

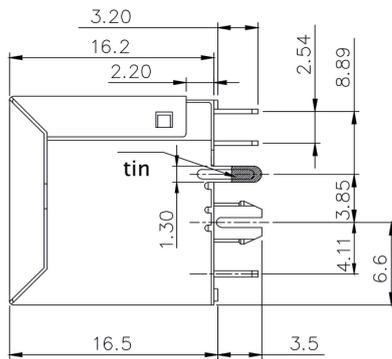
www.weidmueller.com

Изображения

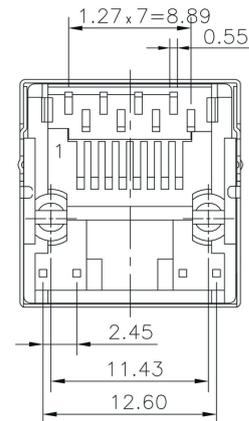
Габаритный чертеж



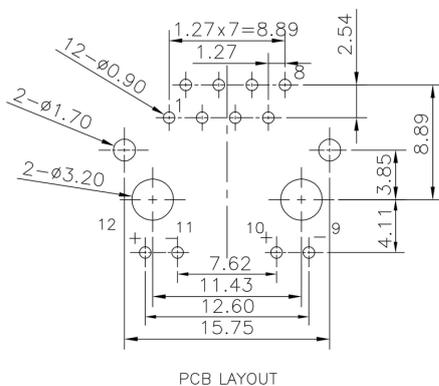
Габаритный чертеж



Габаритный чертеж



Чертеж РСВ платы



RJ45C5 R1V 3.2N4G/Y TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Code	Value	Description
RJ45	G1	RJ45G1
	R1	R1U
	U	U
	3.2	3.2E
	E4	E4
	GY/GY	GY/GY
	TY	TY
RJ45G1 R1U 3.2E4GY/GY TY		
Packaging	TY	Tray in box (manual assembly)
	RL	Tape on Reel (automated assembly)
LED	Y/G	Yellow/Green
	G/Y	Green/Yellow (standard)
	GY/GY	Green-Yellow/Green-Yellow
	O/G	Orange/Green
	R/O	Red/Orange
 (further combinations possible)
	N	without LED
Contact surface thickness	4	1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ"
EMI tabs (ground fingers)	E	E = with EMI tabs
	N	N = without EMI tabs
Solder Pin length	3.2	3.2 mm
	1.6	1.6 mm
	D	SMD
Direction, latch style	U	Horizontal (90°, side entry), latch up
	D	Horizontal (90°, side entry), latch down
	V	Vertical (180°, top entry)
	Y	Diagonal (45°), latch up
Number of Ports	1	1 Port
	12; 14; ...	multi ports side by side, Multiport
	21; 41; ...	multi ports about each other, Multilevel
Assembly on PCB	R	Through Hole Reflow - THR
	S	Soldering process: Wave or Reflow soldering
	SMT	Surface Mount Technology - SMT
	T	Soldering process: Reflow soldering
	THT	Through Hole Technology - THT
	Wave	Soldering process: Wave
Performance Category	C5	Category 5
	C6	Category 6
	C6A	Category 6A
	C5e	Category 5e
	M	10/100 Mbit
	G1	10/100/1000 Mbit
	G10	10 Gbit
	U	Unshielded
	MP	10/100 Mbit with POE
	MP+	10/100 Mbit with POE+

Условные обозначения

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klängenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is ‚activated‘. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.